



EINLADUNG

zum SEMINAR: „Plasma Prozesstechnologie“

Termin: 28. Februar 2013

Veranstaltungsort: SENTECH Instruments GmbH
Schwarzschildstraße 2, 12489 Berlin-Adlershof

Sehr geehrte Damen und Herren,

SENTECH veranstaltet ein anwendungsorientiertes Seminar über

„Plasma Prozesstechnologie“

in den Räumen von SENTECH Instruments in Berlin.

Wir freuen uns, dass wir auch dieses Jahr wieder kompetente Referenten gewinnen konnten, die Ihnen an ausgewählten Beispielen Ätz- und Beschichtungstechniken erläutern werden.

Aktuelle Themen wie das Ätzen von Nano-Strukturen in Si, in Verbindungshalbleitern und in Dielektrika sowie das Abscheiden von Passivierungs- und Verkapselungsschichten mit ICPECVD und ALD werden behandelt. Ein Highlight bildet zudem der Vortrag zu modernen elektronischen Bauelementen auf der Basis von Graphen.

Darüber hinaus werden Mitarbeiter von SENTECH Instruments über Neuentwicklungen berichten und Applikationen aufzeigen.

Wenn Sie wissen wollen, wie moderne schädigungsarme Ätz- und Beschichtungsprozesse funktionieren, sollten Sie sich zum Seminar „Plasma Prozesstechnologie“ anmelden.

Das **Anmeldeformblatt** finden Sie auf der 3. Seite.

Bitte faxen Sie uns Ihre Anmeldung umgehend zu. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Teilnehmer begrenzt.

Auskunft über das Seminar erhalten Sie unter der Telefonnummer: 089 897 9607-0

In der Regel können wir Ihnen die Seminarvorträge zur Verfügung stellen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Berlin-Adlershof und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Ihre
SENTECH GmbH



SEMINAR:
Plasma Prozesstechnologie

am Donnerstag, den 28. Februar 2013
in Berlin-Adlershof
Veranstaltungsort:
SENTECH Instruments GmbH
Schwarzschildstr. 2, Berlin-Adlershof
Tel.: +49 30 6392-5520

Seminarprogramm

9.00 **Begrüßung / Vorstellung des Programms**
SENTECH GmbH, Krailling

Beschichtungstechniken

9.15 **PECVD- und ICPECVD-Abscheidung und Charakterisierung von Si-Oxiden, -Nitriden und -Carbiden**
Xuemei Wang, SENTECH Instruments GmbH, Berlin

9.45 **Abscheidung von hochqualitativen Si-Nitrid-Schichten mit niedrigem Wasserstoffgehalt durch Abscheidung mit ICPECVD**
Wolfgang Bronner, Fraunhofer Institut für Angewandte Festkörperphysik, Freiburg

10.15 **Kontrollierte konforme nano-skalige Abscheidung funktionaler Schichten mit thermischer und plasmaunterstützter ALD**
Hassan Gargouri, SENTECH Instruments GmbH, Berlin

10.45 Kaffeepause und Diskussion

11.00 **Dünnschichtverkapselung von organischer Elektronik mittels Atomlagenabscheidung**
Tim Bülow, TU Braunschweig, Institut für Hochfrequenztechnik, Braunschweig

Ätztechniken

11.30 **Si-Strukturierung für die Herstellung von MEMS und Sensorik**
Ralph-Stephan Unger, SENTECH Instruments GmbH, Berlin

12.00 **Ätzen von GaN-Schichten**
Wilfried John, Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin

12.30 Mittagessen und Diskussion

13.30 **Strukturieren von Glas und Quarz**
Eric Markweg, TU Ilmenau, Fachgebiet Mikromechanische Systeme, Ilmenau

14.00 **Nanostrukturiertes Silizium in der Photovoltaik und Sensorik**
Martin Steglich, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Angewandte Physik, Jena

14.30 **Vorteile induktiv gekoppelten Plasmas in der SI 500 gegenüber kapazitiv gekoppelten Plasmen**
Michael Arens, SENTECH Instruments GmbH, Berlin

15.00 Kaffeepause und Diskussion

15.15 **Endpunktdetektion mit dem neu entwickelten SENTECH Laserinterferometer**
Tomasz Kwapien, SENTECH Instruments GmbH, Berlin

15.45 **Moderne elektronische Bauelemente auf der Basis von Graphen**
Christian Wenger, IHP, Frankfurt (Oder)

16.15 **Alle Teilnehmer des Seminars sind zum Besuch des Applikationslabors bei SENTECH Instruments eingeladen**

17.15 Ende des Seminars